

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于拟向金融机构申请新型政策性金融工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 11 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟向金融机构申请新型政策性金融工具的议案》，具体情况如下：

一、交易情况概述

为积极把握政策机遇，拓宽融资渠道，保障重点项目建设资金需求，公司拟向国家开发银行深圳市分行（以下简称“国开行”）申请新型政策性金融工具借款，借款额度不超过 47,800 万元人民币，借款期限不超过 10 年，借款仅限于公司将其以权益性资金注入广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”），作为基于高阶 HDI 及 MSAP 工艺的超高密 PCB 项目（以下简称“本项目”）的资本金，用于本项目建设。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东会审议。

二、拟签署《借款合同》的主要内容

甲方（委托人）：国开新型政策性金融工具有限公司

乙方（受托人）：国家开发银行深圳市分行

丙方（借款人）：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

（一）委托贷款用途

委托贷款用途：本合同项下委托贷款仅限通过注资形式用于基于高阶 HDI 及 MSAP 工艺的超高密 PCB 项目的资本金投入，具体贷款用途为基于高阶 HDI 及 MSAP 工艺的超高密 PCB

项目建设。

(二) 委托贷款金额、委托贷款期限

- 1、委托贷款金额：人民币 47,800 万元（大写：人民币肆亿柒仟捌佰万元整）。
- 2、委托贷款期限：从合同约定的提款日起，至该日的第 10 个周年日止，共计 10 年。

(三) 委托贷款利率、利息计收方式

- 1、委托贷款利率：贷款利率=基准利率+利差
- 2、利息计收方式：除每笔贷款的首个利息期和最后一个利息期外，合同项下每笔贷款的利息期为 3 个月。

(四) 项目资金注入方式如下：

丙方取得借款后，将资金以权益性资金注入项目公司广州兴森，用于基于高阶 HDI 及 MSAP 工艺的超高密 PCB 项目建设。

(五) 本合同自甲方、乙方和丙方签字并盖章之日起生效。

具体借款金额、条件等均以国开行最终审批结果及实际签署的《借款合同》为准。

三、子公司基本情况

公司名称：广州兴森半导体有限公司

统一社会信用代码：91440112MA9YCAK39Q

成立日期：2022-03-22

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：邱醒亚

注册资本：220,500 万元

注册地址：广州市黄埔区知识城积安路 61 号

经营范围：电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

与公司关系：广州兴森为公司控股子公司。

履约能力分析：公司经营稳定，财务管理规范，具有良好的资信和履约能力。

经在中国执行信息公开网查询，广州兴森非失信被执行人。

四、对公司的影响

本次借款有利于保障高阶 HDI 及 MSAP 工艺的超高密 PCB 项目的顺利实施，有利于提升公司的整体竞争力，符合公司及股东的整体利益。本次借款对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十一日